

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS 超高频器件启动量产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（简称“赛莱克斯北京”或“北京 FAB3”）以 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为机电系统）工艺为某客户制造的 MEMS 超高频器件完成了工艺及性能验证，并于 2023 年 12 月 15 日收到该客户发出的批量采购订单，赛莱克斯北京开始进行 MEMS 超高频器件的商业化规模量产。

MEMS 超高频器件基于 MEMS 工艺和设计技术制造，具有开关效率高，反向恢复快、正向电流大、体积小、使用简便等特点；通过 8 英寸晶圆进行生产，能够实现更好的性能、更高的良率和产出效率；且由于采用了 MEMS 独特的设计技术和产线工艺制造技术，该器件还具备高密度特性，能够实现更好的参数性能，不仅可以在开关电源、脉宽调制器、不间断电源等领域应用，还可广泛用于新能源逆变、超高频电源、工业伺服电机、新能源汽车电机驱动等领域。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为全球通信、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力。

根据产业发展规律及公司境内外产线的实际运营经验，不同类别 MEMS 芯片一般都需要经历从工艺开发到风险试产、规模量产的过程，所耗时间存在差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 17 日